

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成20年5月15日(2008.5.15)

【公開番号】特開2007-35574(P2007-35574A)

【公開日】平成19年2月8日(2007.2.8)

【年通号数】公開・登録公報2007-005

【出願番号】特願2005-221026(P2005-221026)

【国際特許分類】

H 01 B 5/00 (2006.01)

H 01 B 5/16 (2006.01)

H 05 K 3/32 (2006.01)

H 01 R 11/01 (2006.01)

【F I】

H 01 B 5/00 C

H 01 B 5/00 G

H 01 B 5/16

H 05 K 3/32 B

H 01 R 11/01 5 0 1 C

【手続補正書】

【提出日】平成20年4月2日(2008.4.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基材微粒子と、前記基材微粒子の表面に形成された表面に突起を有する導電層とからなる導電性微粒子であって、

前記基材微粒子は、20で測定した粒子直径が10%変位したときの圧縮弾性率(10%K値)が500~2500N/mm<sup>2</sup>、圧縮変形回復率が15~100%であり、突起は、芯物質を有する

ことを特徴とする導電性微粒子。